

10月29日(木)10:00-12:30	コース	10月29日(木)14:00-16:40	10月30日(金)12:50-15:05	10月30日(金)15:35-17:50
<p><b>KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30</b> (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)</p> <p>◆来賓挨拶 京都府副知事 山下 晃正 京都市長 門川 大作</p> <p>◆基調講演: 「SIPプログラム」フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」の構築に向けて」 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー 木村 康則</p> <p>◆基調講演: 「先端技術を支え未来へつなぐHORIBAの「はかる」技術」 ㈱堀場エステック 代表取締役社長 小石 秀之</p> <p>◆基調講演: 「ポストコロナの世界経済は半導体産業が最大ドライバーだ!!」 ～テレワーク、5G高速、データセンタで巨大需要～ ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉</p>	<p><b>【A】次世代モビリティ</b></p> <p><b>【B】5G・AI・ネットワーク</b></p>	<p><b>A-1 with-Corona &amp; post-CoronaのMobility動向</b> 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモティブ)</p> <p>◆「コロナショックが加速する自動車産業・ビジネスの変化」 アーサー・ディ・リトル・ジャパン(株) プリンシパル 濱田 悠 ◆「ポストパンデミック時代のモビリティ革命」 オートインサイト(株) 代表 鶴原 吉郎 ◆「コロナウイルスによる今後の車載カメラ市場への影響」 ㈱テクノ・システム・リサーチ 第1グループ アシスタントディレクター 駒田 隆彦</p> <p><b>B-1 通信・ネットワーク</b> 泉谷渉(産業タイムズ社)/重松智志(NTTエレクトロニクス)/中村孝(大阪大学)</p> <p>◆「光通信の高速・大容量化を切り拓く化合物半導体を用いた超高速アナログ回路技術」 NTT先端集積デバイス研究所 光子学融合研究部 高速アナログ回路研究グループ 特別研究員 長谷 宗彦 * ◆「無線通信の進展を支える高周波材料・デバイス ～光電子移動度トランジスタ(HEMT)技術を中心に～」 ㈱富士通研究所 デバイス&amp;マテリアル研究センター 特任研究員 渡部 慶二</p>	<p><b>A-2 モビリティ進化を支える革新的キーテクノロジー</b> 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモティブ)</p> <p>◆「ADAS/自動運転のための画像認識AI」 ㈱東芝 研究開発本部 研究開発センター メディアAIラボラトリー 主任研究員 関 晃仁 ◆「車載システムの安全規格動向と電子デバイスへの期待」 名古屋大学 大学院情報学研究所 情報システム学専攻 准教授 松原 豊 * ◆「モビリティサービスとこれからのクルマ社会」 ㈱Mobility Technologies 次世代事業部 自動運転タクシーグループ グループリーダー 竹村 紀章 *</p> <p><b>B-2 エッジAIデバイスを支える革新技术</b> 石田昌宏(パナソニック)/中村孝(大阪大学)</p> <p>◆「不揮発性ロジックが拓く脳型コンピューティングの挑戦」 東北大学 電気通信研究所 教育研究評議員 教授 羽生 貴弘 * ◆「エッジAIとクラウドで作るAI×IoTシステムの今とこれから」 ㈱HAGARUS 取締役 CTO 柴田 貴志 ◆「アルゴリズムとハードウェアの協調による効率的な深層学習システム」 LeapMind ㈱ 執行役員 CRO (Chief Research Officer &amp; Chief Scientist) 兼村 厚範</p>	<p><b>A-3 次世代車載パワーデバイス</b> 中村孝(大阪大学)/佐藤高京(京都大学)</p> <p>◆「rEV用パワーデバイスの市場概況とSiCの可能性」 ㈱矢野経済研究所 モビリティ産業テクノロジーグループ グループ長 主席研究員 池山 智也 ◆「電動車への搭載が広がるRC-IGBT(逆導通IGBT)の開発」 富士電機㈱ 電子デバイス事業本部 開発統括部 デバイス開発部 部長 椎木 崇 ◆「車載市場向けSiCパワーデバイスの取り組み」 ローム㈱ システムソリューションズ(シリコン)本部 FAE1部 ハイパーFAE課 電動パワートレインG グループリーダー 榎本 晋文</p> <p><b>B-3 5Gの最前線</b> 加藤千晴(村田製作所)/戸所義博(イーセップ)</p> <p>◆「5G・IoTによるデジタルトランスフォーメーションの加速」 KDDI㈱ サービス企画開発本部 5G・IoTサービス企画部 部長 野口 一宙 * ◆「5G無線ネットワークの高度化」 日本電気㈱ ワイヤレスアクセシビリティソリューション事業部 事業部長代理 大神 正史 ◆「5Gモバイルシステムのグローバル商用化動向」 華為技術日本㈱ CTO &amp; CSO 赤田 正雄</p>
<p>10月30日(金)9:30-11:55</p> <p><b>KM-2 マーケティングセッション</b> 9:30-11:55 (受付 9:00 開始)</p>	<p><b>【C】最先端半導体飛躍の時</b></p>	<p><b>C-1 世界をリードする日本の半導体材料技術(AIによる材料探索、CNT、FOWLP)</b> 酒井滋樹(日新イオン機器)/藤原健典(東レ)</p> <p>◆「ビッグデータ時代におけるAIの重要性 ～AIは新材料を見つけることができるのか?～」 長瀬産業㈱ 執行役員 NVIC室 室長 折井 靖光 ◆「カーボンナノチューブの電子デバイスへの応用」 日本ゼオン㈱ 総合開発センター CNT研究所 所長 上島 貢 * ◆「Fan-Out WLP向けチップ再配列プロセスへの提案」 リンテック㈱ アドバンスドマテリアルズ事業部門 次世代技術革新グループ 副部長 田久 真也</p>	<p><b>C-2 進化を続ける半導体プロセス・装置技術</b> 森義弘(SCREEN)/廣田良浩(東京エレクトロ)</p> <p>◆「PoRAM技術とAI応用」 ㈱アルバック 執行役員 シニアフェロー 部 弘綱 * ◆「3D NANDスケールアップのためのプロセス技術と材料開発」 Applied Materials, Inc. Integrated Materials Solution Director 北島 知彦 * ◆「最先端デバイスを支えるエッチング技術動向」 東京エレクトロ宮城㈱ 技術戦略室 グループリーダー 坂本 渉 *</p>	<p><b>C-3 5G・AI・IoT時代を支える半導体デバイス・回路技術</b> 廣田良浩(東京エレクトロ)/三富士道彦(ローム)</p> <p>◆「3D NANDの技術動向と課題」 マイクロメモリジャパン合同会社 NAND フェロー 合田 晃 ◆「三次元ニューラルネットの実現に向けた抵抗変換型メモリと酸化物半導体トランジスタのモノシック集積」 東京大学 工学系研究科システムデザイン研究センター(d.lab) 准教授 小林 正治 ◆「スマートビジョンセンサ」 ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱ 第1研究部門 5部 担当部長 若林 隼人 *</p>
<p>◆特別講演 「「コロナ禍」と戦う半導体デバイス・電子部品業界の現状と展望」 ㈱産業タイムズ社 大阪支局 編集部 記者 中村 剛</p> <p>◆特別講演 「コロナ後のエレクトロニクスを牽引する5Gとデータセンタ」 Informa Tech(OMDIA) Senior Consulting Director 南川 明</p>	<p><b>【D】特別セッション</b></p>	<p><b>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム</b> 戸所義博(イーセップ)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)</p> <p>◆「プラズマプロセスを用いた超微細加工における最新の課題と今後の展望」 京都大学 工学部・大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 江利口浩二 * ◆「工業用ポリマーを基盤とした構造色技術」 京都大学 高等研究院 物質-細胞統合システム拠点 特任助教 伊藤 真輝 ◆「フレキシブル薄膜電子デバイスによる生体信号計測」 大阪大学 産業科学研究所 先端電子デバイス研究分野 関谷研究室 特任准教授 權村 隆文 ◆「生体組織イメージングデバイス」 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 准教授 笹川 清隆</p>	<p><b>D-2 パッケージング市場動向と最新技術動向(FOWLP/μLED)</b> 藤原健典(東レ)/不破保博(元ローム㈱)</p> <p>◆「Beyond 5Gに向けてのパッケージ技術の挑戦課題」 ㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦 ◆「先端パッケージング技術動向およびファンアウト基板への直接固着技術」 SCREENセミコンダクターソリューションズ㈱ フロンティア技術統轄部 露光プロダクト部 部長 波多野 真人 ◆「Micro LEDディスプレイ製造トータルソリューションの紹介」 東レエンジニアリング㈱ メカトロファインテック事業本部 第一事業部 営業部 戦略営業チーム 主席技師 森 英治</p>	<p><b>D-3 最新接合技術を用いたパッケージングに関する材料・装置関連</b> 森川泰宏(ULVAC)/酒井滋樹(日新イオン機器)</p> <p>◆「次世代接合技術と装置」 ズース・マイクロテック㈱ ビジネスデベロップメント ウエハボンディング 部長 石田 博之 ◆「変える力とつながり度でIoT実装に革命を」 コネクテックジャパン㈱ 代表取締役 CEO 平田 勝則 ◆「5G通信への応用可能な特性の実現を目指したLT/Quartz複合SAW基板の作製」 早稲田大学 ナノ・ライフ創研機構 研究院教授 水野 潤</p>
<p>◆特別講演 「新型コロナその後:外れた予想、当たった予想、今後をどう見る?」 ～スマホ/FPD、ソニー、シャープなど～ みずほ証券㈱ ㈱エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫</p>	<p><b>連絡事項・注意事項等</b></p>	<p>◆京都リサーチセンター(KRPC)新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(抜粋) 1. 入館の制限について ①軽度であっても、風邪のような症状(発熱、席、咽頭痛など)がある方 ②国内外で、感染が疑われる方と長時間接触があった方 ③過去2週間の間に政府の入国制限、入国後観察期間が設定されている国・地域への渡航歴のある方 2. 注意事項 ①3密(密閉空間、密集場所、密接場面)は避ける ②マスクの着用、手指の消毒、会話を控える ③来場者・主催者の名簿を作成し、個人情報保護に注意して保管しておく ④展示等は、シールド等を設置し、密集しないように注意のこと ⑤会議室の収容人員は、席の間隔を確保するため、通常の50%程度となる</p>	<p>◆「第7回電子デバイスフォーラム京都」での対応 1. WEBでの参加を併用 ①会場参加は会場の収容人員を超えた場合は、募集停止とします ②WEB参加は、Teamsを使用しています (各セッションごとに参加者の登録を行い、登録者のみの参加に限定します) ③WEB参加者には、申込セッションの予集票を事前に送付します 2. その他 ①レセプションは中止となります ②展示は、シールド等の感染防止の注意をし、行います。 ③基調講演、マーケティングセッションは、別会場でのサテライトを考えます ④講師が移動できない場合は、一部WEB講演を行う場合もあります</p>	